DATENBLATT

DSub Buchse, Schneid-Klemme, flache Bauform, EDFF 25 LPIII/Z



Beschreibung

Die 25-polige D-Sub Buchse von EFB-Elektronik in flacher Bauform ist für kompakte Steckverbindungen mit weiblicher Kontaktausführung ausgelegt. Mit 180°-Anschlusswinkel und Schneidklemme eignet sie sich für die normgerechte Integration auf der Leiterplatte und für Anwendungen mit Flachkabel.

- 25-polige D-Sub Buchse für kompakte Verbindungen
- 180°-Ausführung mit weiblicher Kontaktausführung
- Für Flachkabel mit Leiterquerschnitt 28AWG bis 26AWG

Durch den Temperaturbereich von -25 bis 85 °C ist die Ausführung EDFF 25 LPIII/Z für anspruchsvolle Umgebungen vorgesehen. Die Kombination aus flacher Bauform, Schneidklemme und präziser Steckgeometrie unterstützt eine belastbare Signalverbindung in industriellen und technischen Applikationen.

Technische Details
- Typ: EDFF 25 LPIII/Z
- Anschlussart: sonstige
- Anschusswinkel: 180°
- Ausführung: Buchse
- Kontaktausführung: weiblich (female)
- Polzahl: 25
- Für Kabeltyp: flach
- Leiterquerschnitt: 28AWG ~ 26AWG
- Temperaturbereich: -25 – 85 °C
- Marke: EFB-Elektronik
- Verpackung: 40 Stück pro Blister

Technische Eigenschaften

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

DSub Buchse, Schneid-Klemme, flache Bauform, EDFF 25 LPIII/Z

Anschlussart	sonstige
Anschusswinkel (180°/90°)	180
Ausführung	Buchse
Für Kabeltyp (rund/flach)	flach
Herstellungsart der Kontakte (gedreht/gestanzt)	gestanzt
Kontaktausführung	weiblich (female)
Leiterquerschnitt	28AWG ~ 26AWG
Temperaturbereich	-25 – 85

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Polzahl	Typ	Verpackung	Anzahl der Reihen
29010.1	DSub Buchse, Schneid-Klemme, flache Bauform, EDFF 09 LPIII/Z	9	EDFF 09 LPIII/Z	90 Stück pro Blister	2
29011.1	DSub Buchse, Schneid-Klemme, flache Bauform, EDFF 15 LPIII/Z	15	EDFF 15 LPIII/Z	70 Stück pro Blister	2
29012.1	DSub Buchse, Schneid-Klemme, flache Bauform, EDFF 25 LPIII/Z	25	EDFF 25 LPIII/Z	40 Stück pro Blister	2

Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

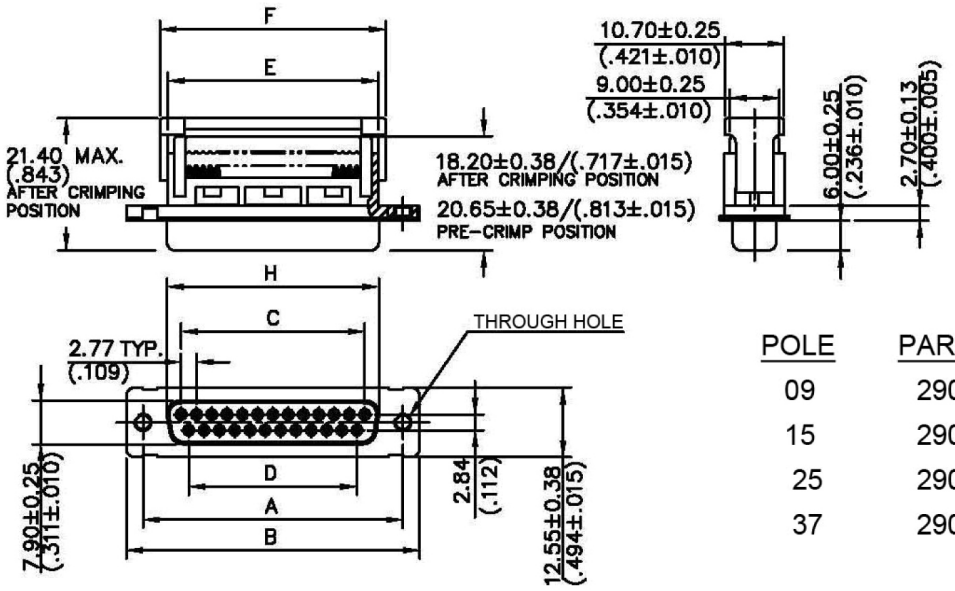
fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

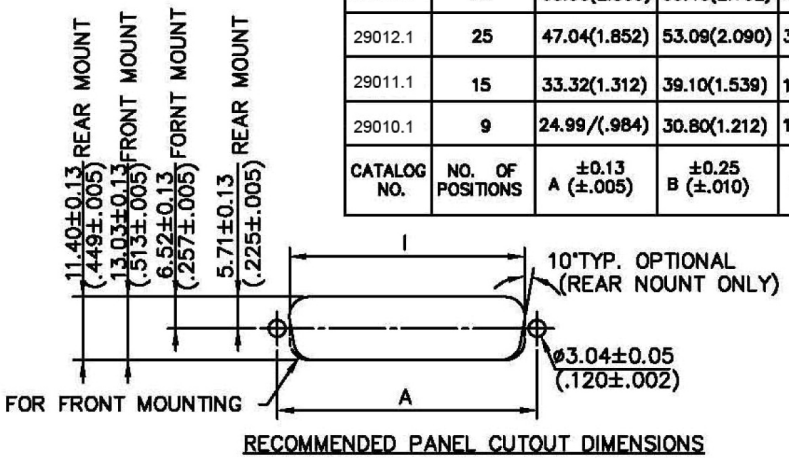
WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

DSub Buchse, Schneid-Klemme, flache Bauform, EDFF 25 LPIII/Z



POLE	PART NO.
09	29010.1
15	29011.1
25	29012.1
37	29013.1



CATALOG NO.	NO. OF POSITIONS	±0.13 A (±.005)	±0.25 B (±.010)	±0.13 C (±.005)	±0.13 D (±.005)	±0.25 E (±.010)	±0.25 F (±.010)
29013.1	37	63.50(2.500)	69.40(2.732)	49.86/(1.963)	47.09/(1.854)	54.60/(2.150)	57.10/(2.248)
29012.1	25	47.04(1.852)	53.09(2.090)	33.24/(1.309)	30.47/(1.200)	38.14/(1.502)	40.90/(1.610)
29011.1	15	33.32(1.312)	39.10(1.539)	19.39/(.763)	16.62/(.654)	24.00/(.945)	26.60/(1.047)
29010.1	9	24.99/(.984)	30.80(1.212)	11.08/(.436)	8.31/(.327)	16.10/(.634)	18.60/(.732)

54.84/(2.159)	59.08/(2.326)	60.73/(2.391)
38.38/(1.511)	42.52/(1.674)	44.27/(1.743)
24.66/(.971)	28.80/(1.134)	30.53/(1.202)
16.33/(.643)	20.47/(.806)	22.20/(.874)
H ±0.25 (±.010)	I± 0.13/(.005) REAR MOUNTIONG	I± 0.13/(.005) FRONT MOUNTING

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION